シリコンフォトニクス

Ge-on-Siエミッタが シリコンフォトニクスを前進させる

最近の数年で、シリコン(Si)ベースのフォトニックデバイスの開発は急増した。しかし、Siルータ(www.laserfocus world.com/articles/343738を参照)、モジュレータ、導波路、スイッチ、Siフォトダイオード(www.laserfocusworld.com/articles/347384を参照)のほか、

n+接合

ハイブリッドSiレーザ(www.laserfocus world.com/articles/343731を参照)の 開発にさえ成功したにもかかわらず、シリコンフォトニックコンポーネントを集積した全Siレーザはいまだに実現の見込みは立っていない。この議論は、シリコンフォトニクスのインターチッ

p+接合

プおよびイントラチップネットワーク (www.laserfocusworld.com/articles/ 353971を参照)実現に向けた正しいロードマップに沿って激化しているため、いくつかの研究グループは真の意味で電気的に注入されたSi光源の開発において前進を遂げている。

米カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究グループによる最近の4.2 mWの電気的に励起されたハイブリッドエバネッセントシリコン/ヒ化リン化インジウムガリウム(Si/InGaAsP)レーザの実証に加えて、米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループも室温で直接遷移(ダイレクトバンドギャップ)のエレクトロルミネッセンス(EL)を示すモノリシックに集積されたゲルマニウム・オン・シリコン(Ge-on-Si)発光ダイオード(LED)を作製した(1)、(2)。

n+ poly Si SiO₂ Ge p+Si基板 波長(nm) 1700 1600 1500 1400 Integral EL (a.u.) モデル値 10 0.5 EL(a.u.) 0.0 60 電流(mA) 5 0.75 0.90 0.95 0.70 0.80 光子エネルギー(eV)

図1 モノリシックに集積されたGe-on-Siデバイス(上)は室温で直接遷移ルミネッセンスを示した。エレクトロルミネッセンス(下のスペクトル)は電気的に注入された電流(挿入グラフ)の関数として強度を上昇させる。(資料提供:MIT)

シリコンハイブリッド以上の良さ

電流注入は、Si導波路に接着された、もしくはSiベースの緩衝層上に成長させた1550nmハイブリッドⅢ-V Siレーザにおいて可能だが、作製コストが高いため大量生産は難しい。相補型金属酸化膜半導体(CMOS)製造プロセスと互換性のあるモノリシックに集積されたエミッタのほうがより優れたアプローチだ。これは、MITチームが開発したGe-on-Si LEDによってもたらされた結果だ。

Siとは異なり、Geは自身の間接遷移よりも僅かしか大きくない(0.136eVの差) 直接遷移をもつ。非放射プロセスから の非常に低い損失で、放射で正孔と再結 合した伝導帯の垂直な溝に電子を注入 するように設計できる。観察された直接ギャップのフォトルミネッセンスは、Si上のエピタキシャルGe 薄膜への内面 2軸の引張応力を取入れることによって押し上げられた。計算では、Ge は 2%の引張歪み値で0.5eV (2500nm)の直接遷移材料となるため、0.20~0.25という小さな歪み値が発生し、これによってより高い品質と信頼性をもつ材料の1550nmの通信波長近傍でのバンドギャップが得られる。

デバイスは、ホウ素ドープのSi基板上に成長させたエピタキシャルGeによって作製された。この基板上に蒸着した二酸化ケイ素 (SiO_2) 層は、これに続くGeの成長用の領域を露光するためパタン化される(図1)。0.20%の引張歪み

を発生させるため室温により冷却の後、 1.7μ m厚のGe層を緩和させるため、成長後の熱アニールが施された。最終被覆としてnおよびp接合とともに多結晶Siが加えられた。

電流注入が50mAの電流で20×100 μmのデバイスに適用され、0.77eV(または1610nm)の直接遷移エネルギーで光学放射を発生した。これは、研究グループが把握する限り、Geデバイスから初めて観察された直接遷移のエレクトロルミネッセンスだ。この直接遷移エレクトロルミネッセンスは注入された電流と超線形の関係を示すため、

Ge-on-Siデバイスは電気的励起やモノリシックなSi上の光エミッタとして有望な候補となる。

MITの研究者であるシャオチェン・サン氏は「Ge は可能性のある効率的な光エミッタとして、ごく最近まで真剣に検討されてはいなかった。MITによる引張歪みの Ge に対する広範囲な研究によって、Ge LEDの実現に向かっている。ミリワットのオンチップ光エミッタを目指して数桁の性能向上のためさらなる設計や最適化が行われることになっている」と語っている。

(Gail Overton)

参考文献

- (1) X.Sun et al., Optics Lett. 34(9) p. 1345 (May 1, 2009).
- (2) X. Sun et al., Optics Lett. 34(8) p. 1198 (April 15, 2009).

LFWJ